フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー (FE-EPMA)



FE-EPMAの特長

フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー(Field emission electron probe micro-analyzer: FE-EPMA)はショットキー電子銃によ り高電流で微小プローブを得られるため高空間分解能で観察が可能です。 また波長分散型X線分光(WDS)の高エネルギー分解能(約10 eV)でB~ Uの特性X線を検出できます(EDSの分解能は約130 eV)。座標リンク機能 を用いると測定座標を記憶でき効率的な実験ができます。ZAF法や薄膜定 量法(PRZ法)によりバルクや薄膜の定量分析も可能です。またEBSD Electron back scattering diffraction)を備え結晶方位を把握できます。

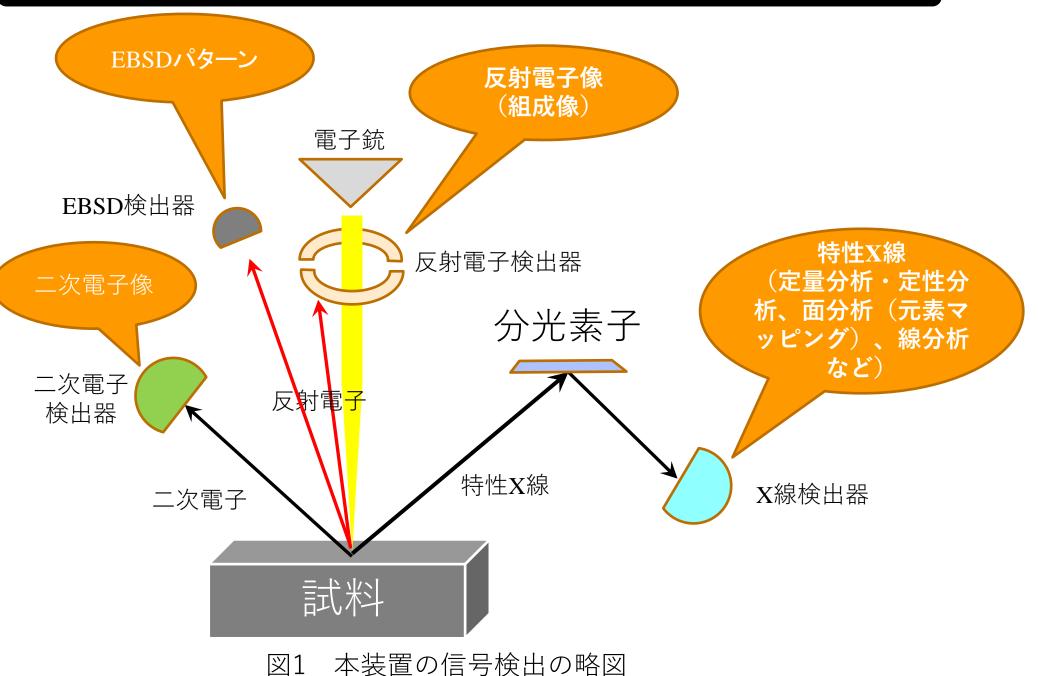


【この装置でできること】

- ·SEM観察(二次電子像観察、 反射電子像観察など)
- ・WDS分析(定量分析、ライン 分析、面分析、薄膜の定量分析 (PRZ法) など)
- ·EBSD分析(結晶方位、結晶 粒径、結晶粒形状等OIM観察)

当センターのFE-EPMA (JXA-8530F, JEOL)外観と得られる情報

本装置の信号検出と分光素子の種類

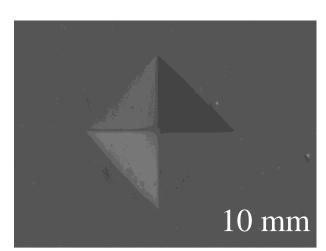


観察と分析の例 接合界面

【反射電子像(BSE像)】

照射電子のうち弾性散乱した高エネルギーの反射 電子像で原子番号が大きいほど発生する反射電子 量が多く、組成の違いを知ることができます。

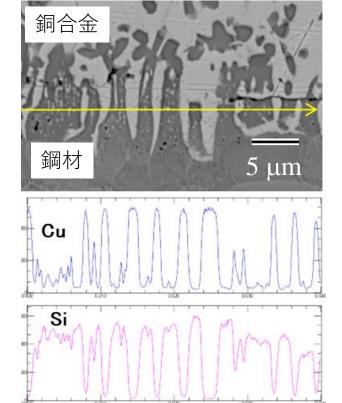
図2 反射電子像(鋼材と銅合金バイメタル)



【二次電子像(SE像)】

照射電子(一次電子が試料に衝突後に表面から二 次的に発生する低エネルギーの電子を二次電子検 出器で検出した像で、試料の凹凸が判ります。

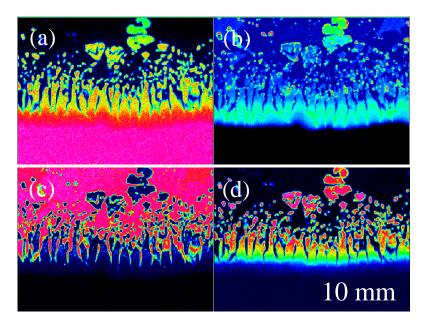
図3 二次電子像(ビッカース圧痕)



【線分析(ライン分析)】

試料面内で電子線を一直線にスキャンした時に 発生した特性X線の強度の変化から直線上での元 素の分布が判ります。

図4 反射電子像 (a) とラインプロファイル (b) : (b)は(a)の黄色線に沿って分析したCuとSiの分布 で、(a)でdarkな領域にはSiが、brightの領域には Cuが濃化していることが判る。



【面分析(元素マッピング)】

面分析を行うことで観察面内で試料に含 まれている複数の元素がどのように分布 しているかを知ることができます。

図5 鋼材と銅合金接合材のWDS分析(a) Fe, (b) Si, (c) Cu, (d) Al : 界面から鋼材側に 柱状晶が発達しAlとSiが濃化。

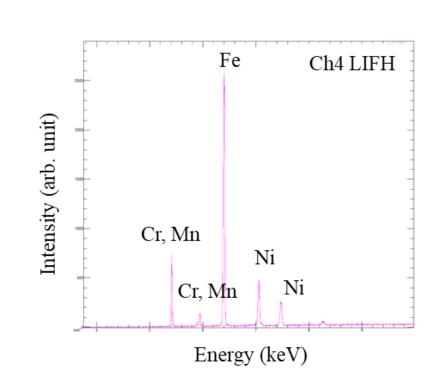
本装置のWDS分光結晶 / 分光素子の構成

Ch1	Ch2	Ch3	Ch4
LIF	TAP	LDE1H	LIFH
PETJ	LDE2	LDE2H	PETH

LIF (Lithium Fluoride), PET (Pentaerythritol), TAP (Thallium acid phthalate)、H型はローランド 円の径が小さく、分析範囲は狭く、エネルギー分解能は悪いが、特性X線強度は大きくなる

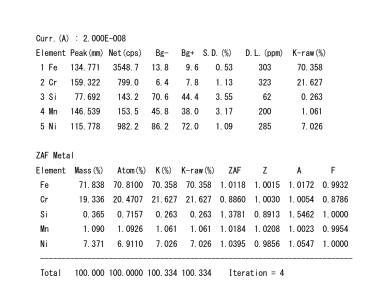
表2 各分光結晶 / 分光素子の検出可能元素

結晶または 分光素子	面間隔 2d(nm)	検出元素(K線)	検出元素(L線)	検出元素(M線)
LIF	0.4027	K~Rb(H型: Ca~Ga)	Cd~U (H型はSn~Au)	-
PET	0.8742	Al~Mn (H型はSi~Ti)	Kr~Tb(H型はRb~Ba)	Yb~U(H型はHf~U)
TAP	2.5757	O ~ P	Cr ~ Nb	La ~ Au
LDE1	≒ 6	N, O, (FはH型は不可)	-	_
LDE2	≒ 10	B, C, N, (Oも可)	_	_



【定性分析】 定性分析では、分光結晶位置(L値:エ ネルギーに換算される値)を全範囲スキャンすること で検出される特性X線から未知試料にどのような元素 が含まれているかがわかります。左の例ではCr, Mn, Fe, Niが検出されています。

図6 SUS304の定性分析結果



【定量分析】定量分析ではバルク用ZAF補正と薄膜用 PRZ補正を用い、組成既知の標準試料を参照して定量 します。また、薄膜用のPRZ法では標準試料に加え、 試料作製に用いた基板(薄膜が載っていない試料)が 必要です。

図7 SUS304の定量分析結果

【EBSD分析】70°傾斜した試料面に電子線を照射して発生する反射電子によるEBSDパタ ーンを用いて面方位を指数付けし、OIM(Orientation Imaging Mapping)と称します。

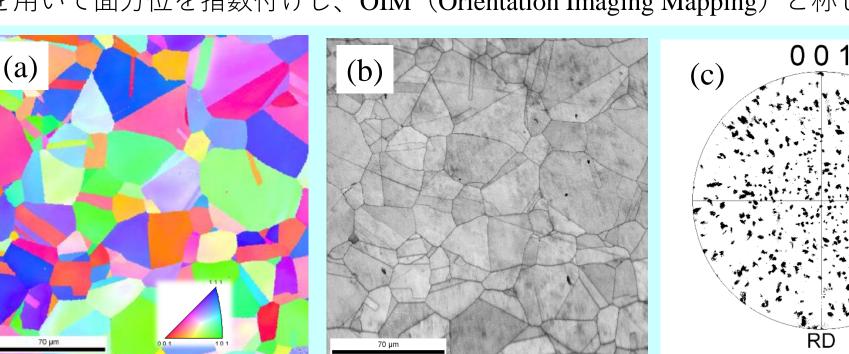


図8 Niの分析例:(a) ND方向逆極点図マップ、(b) Image quality (IQ) マップ、(c) 001正極点図

2022.8作成